

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零二零年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2020年11月10日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二零年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二零年第三季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入創歷史新高，達 2.530 億美元，同比上升 5.9%，環比上升 12.3%。
- 毛利率 24.2%，同比下降 6.8 個百分點，環比下降 1.8 個百分點。
- 期內溢利 110 萬美元，上年同期為 4,440 萬美元，上期為 130 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 1,770 萬美元，上年同期為 4,520 萬美元，上季度為 1,780 萬美元。
- 基本每股盈利 0.014 美元，上年同期為 0.035 美元，與上期持平。
- 淨資產收益率（年化）3.2%。

二零二零年第四季度指引

- 我們預計銷售收入約 2.69 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 21%至 23%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對第三季度業績評論到：

“我們對華虹半導體二零二零年第三季度的業績非常滿意。公司第三季度銷售收入創出新高，連續兩個季度實現環比雙位數增長。儘管全球新冠疫情還未得到完全控制，半導體產業景氣度已經逐步提升，尤其是國內消費回暖顯著，持續釋放終端需求。在MCU、IGBT以及邏輯芯片等產品的強烈需求推動下，公司取得了2.53億美元營收的歷史佳績。8吋產能利用率持續旺盛，三座8吋廠第三季度的產能利用率均超過100%；12吋產能利用率也大幅提升。受益於產能利用率的提升，毛利率也超過指引，公司實現連續39個季度盈利。”

“華虹無錫12吋新產品的導入按工藝開發計畫穩步推進，良率提升與產能爬坡速度均遠快於原計劃。目前，12吋嵌入式閃存、邏輯射頻與低壓功率器件三大平臺持續量產出貨。第四季度還將有更多高壓功率器件IGBT和超級結等新產品陸續交付驗證。下階段的工作重點仍是加快無錫新廠產能建設，以緩解現有八吋產能受限的情況，並加速各工藝平臺開發及完善，為更多客戶提供更全面、更優質的產品解決方案。”

“面對全球第二波新冠疫情風險，我們要牢牢守住疫情防控‘上半場’的成果，保持與國內外設備廠商、客戶密切溝通，積極拓展市場深化合作。在此感謝所有股東、客戶、廠商的鼎力支持，以及全體員工的不懈努力。前進的道路雖然總是充滿挑戰，但我們有著必勝的信念和腳踏實地的努力，相信接下來會交出更加亮眼的成績單！”

電話會議公告

日期： 二零二零年十一月十一日（星期三）

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）
上午 03:00（紐約，2020 年 11 月 11 日，星期三）

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或
<https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor/index.jsp?seid=149>
(注：需要註冊才能訪問網絡直播)

電話詳細：	中國大陸	+86 400 624 0406 或 +86 800 870 0531
	中國香港	+852 3018 6768
	中國臺灣	+886 2 7703 1751
	新加坡	+65 6713 5521
	美國	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 7835687

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。(重播密碼: Huahong)

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等特色工藝平台，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有 8+12 英寸生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內建有一座 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），月產能規劃為 4 萬片。華虹七廠於 2019 年正式落成並邁入生產運營期，成為中國大陸領先的 12 英寸特色工藝生產線，也是大陸第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	252,981	238,993	225,350	5.9 %	12.3 %
銷售成本	(191,689)	(164,981)	(166,840)	16.2 %	14.9 %
毛利	61,292	74,012	58,510	(17.2)%	4.8 %
毛利率	24.2%	31.0%	26.0 %	(6.8)	(1.8)
經營開支	(74,200)	(40,184)	(62,512)	84.7 %	18.7 %
其他收入淨額	24,056	23,517	12,000	2.3 %	100.5 %
稅前溢利	11,148	57,345	7,998	(80.6)%	39.4 %
所得稅開支	(10,046)	(12,924)	(6,737)	(22.3)%	49.1 %
期內溢利	1,102	44,421	1,261	(97.5)%	(12.6)%
淨利潤率	0.4%	18.6%	0.6 %	(18.2)	(0.2)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	17,694	45,225	17,826	(60.9)%	(0.7)%
非控股權益	(16,592)	(804)	(16,565)	1,963.7 %	0.2 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.014	0.035	0.014	(60.0)%	-
攤薄	0.013	0.035	0.014	(62.9)%	(7.1)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	577	524	523	10.1 %	10.3 %
產能利用率 ¹	95.8 %	96.5 %	93.4 %	(0.7)	2.4
淨資產收益率 ²	3.2 %	8.4 %	3.2 %	(5.2)	-

二零二零年第三季度

- 銷售收入創歷史新高，達 2.530 億美元，同比上升 5.9%，環比上升 12.3%，主要得益於晶圓銷售量上升。
- 銷售成本 1.917 億美元，同比上升 16.2%，環比上升 14.9%，主要由於晶圓銷售量上升和折舊費用上升所致。
- 毛利率 24.2%，同比下降 6.8 個百分點，環比下降 1.8 個百分點，主要由於折舊費用及無錫新廠的固定成本上升。
- 經營開支 7,420 萬美元，同比上升 84.7%，主要由於無錫工廠的研發開支及固定費用的上升，環比上升 18.7%，主要由於研發開支及人工費用的上升。
- 其他收入淨額 2,410 萬美元，同比上升 2.3%，主要由於政府補貼及分佔一家聯營公司溢利增加，部分被以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及利息收入減少所抵消，環比上升 100.5%，主要由於政府補貼增加，及本期實現匯兌收益而上期為匯兌損失。
- 所得稅開支 1,000 萬美元，同比下降 22.3%，主要由於應課稅利潤減少。
- 期內溢利 110 萬美元，上年同期為 4,440 萬美元，上季度為 130 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 1,770 萬美元，上年同期為 4,520 萬美元，上季度為 1,780 萬美元。
- 基本每股盈利 0.014 美元，上年同期為 0.035 美元，與上期持平。
- 淨資產收益率（年化）3.2%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
華虹 8 吋					
銷售收入	236,378	238,993	215,862	(1.1)%	9.5 %
毛利	64,278	74,012	59,711	(13.2)%	7.6 %
毛利率	27.2 %	31.0 %	27.7 %	(3.8)	(0.5)
經營開支	(30,791)	(26,883)	(26,342)	14.5 %	16.9 %
稅前溢利	45,009	58,984	41,804	(23.7)%	7.7 %
息稅折舊及攤銷前利潤	80,035	85,092	74,371	(5.9)%	7.6 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	33.9 %	35.6 %	34.5 %	(1.7)	(0.6)
付運晶圓(8 吋仔片)	537	524	501	2.5 %	7.2 %
華虹無錫					
銷售收入	16,603	-	9,488	N/A	75.0 %
毛利	(2,986)	N/A	(1,201)	N/A	148.6 %
毛利率	(18.0)%	N/A	(12.7)%	N/A	(5.3)
經營開支	(43,409)	(13,301)	(36,170)	226.4 %	20.0 %
稅前溢利	(33,861)	(1,639)	(33,806)	1,966.0 %	0.2 %
息稅折舊及攤銷前利潤	(11,517)	(1,639)	(18,493)	602.7 %	(37.7)%
息稅折舊及攤銷前利潤率	(69.4)%	N/A	(194.9)%	N/A	125.5
付運晶圓(折合 8 吋仔片)	40	-	22	N/A	81.8 %

華虹 8 吋

- 銷售收入 2.364 億美元，同比下降 1.1%，環比上升 9.5%，主要得益於晶圓銷售量上升。
- 毛利率 27.2%，同比下降 3.8 個百分點，主要由於折舊費用上升，部分被產能利用率提升所抵消，環比下降 0.5 個百分點。
- 經營開支 3,080 萬美元，同比上升 14.5%，環比上升 16.9%，主要由於人工及折舊費用增加。
- 稅前溢利 4,500 萬美元，同比下降 23.7%，環比上升 7.7%。

華虹無錫

- 銷售收入 1,660 萬美元，環比上升 75.0%。
- 經營開支 4,340 萬美元，上年同期為 1,330 萬美元，上期為 3,620 萬美元，主要由於研發費用增加。
- 稅前虧損為 3,390 萬美元。
- 息稅折舊及攤銷前虧損 1,150 萬美元，較上季度減少 700 萬美元。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	244,380	96.6 %	233,006	97.5%	11,374	4.9 %
其他	8,601	3.4 %	5,987	2.5%	2,614	43.7 %
銷售收入總額	252,981	100.0 %	238,993	100.0%	13,988	5.9 %

- 本季度 96.6% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	236,378	93.4 %	238,993	100.0%	(2,615)	(1.1)%
12 吋晶圓	16,603	6.6 %	-	-	16,603	N/A
銷售收入總額	252,981	100.0 %	238,993	100.0%	13,988	5.9 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.364 億美元及 1,660 萬美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	165,258	65.4 %	148,649	62.2 %	16,609	11.2 %
美國	34,144	13.5 %	35,328	14.8 %	(1,184)	(3.4)%
亞洲 ⁴	30,446	12.0 %	29,648	12.4 %	798	2.7 %
歐洲	16,444	6.5 %	17,292	7.2 %	(848)	(4.9)%
日本 ⁵	6,689	2.6 %	8,076	3.4 %	(1,387)	(17.2)%
銷售收入總額	252,981	100.0 %	238,993	100.0%	13,988	5.9 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 1.653 億美元，占銷售收入總額的 65.4%，同比增長 11.2%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 3,410 萬美元，同比減少 3.4%，主要由於超級結產品的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,040 萬美元，同比增長 2.7%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,640 萬美元，同比減少 4.9%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度來自於日本的銷售收入 670 萬美元，同比減少 17.2%，主要由於邏輯產品的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	87,396	34.6 %	88,198	36.9 %	(802)	(0.9)%
分立器件	96,244	38.1 %	90,283	37.8 %	5,961	6.6 %
模擬與電源管理	33,512	13.2 %	36,506	15.3 %	(2,994)	(8.2)%
邏輯及射頻	32,661	12.9 %	22,000	9.2 %	10,661	48.5 %
獨立非易失性存儲器	2,796	1.1 %	1,750	0.7 %	1,046	59.8 %
其他	372	0.1 %	256	0.1 %	116	45.3 %
銷售收入總額	252,981	100.0 %	238,993	100.0%	13,988	5.9 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 8,740 萬美元，同比減少 0.9%，主要由於智能卡芯片的需求減少，大部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 9,620 萬美元，同比增加 6.6%，主要得益於通用 MOSFET 及 IGBT 產品的需求增加，部分被超級結產品的需求減少所抵消。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,350 萬美元，同比減少 8.2%，主要由於模擬產品的需求減少。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 3,270 萬美元，同比增長 48.5%，主要得益於邏輯產品的需求增加，部分被射頻產品的需求減少所抵消。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 280 萬美元，同比增長 59.8%，主要得益於閃存產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13 μ m 及以下	83,771	33.1 %	80,914	33.9 %	2,857	3.5 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	37,576	14.9 %	35,893	15.0 %	1,683	4.7 %
0.25 μ m	4,951	2.0 %	3,249	1.4 %	1,702	52.4 %
0.35 μ m 及以上	126,683	50.0 %	118,937	49.7 %	7,746	6.5 %
銷售收入總額	252,981	100.0 %	238,993	100.0%	13,988	5.9 %

- 本季度 0.13 μ m 及以下工藝技術節點的銷售收入 8,380 萬美元，同比增長 3.5%，主要得益於 MCU 及邏輯產品的需求增加，部分被智能卡芯片及射頻產品的需求減少所抵消。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,760 萬美元，同比增長 4.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 500 萬美元，同比增長 52.4%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.267 億美元，同比增長 6.5%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二零年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第三季度 % (未經審核)	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	158,580	62.7 %	145,954	61.1 %	12,626	8.7 %
工業及汽車	50,355	19.9 %	60,248	25.2 %	(9,893)	(16.4)%
通訊	34,833	13.8 %	23,609	9.9 %	11,224	47.5 %
計算機	9,213	3.6 %	9,182	3.8 %	31	0.3 %
銷售收入總額	252,981	100.0 %	238,993	100.0%	13,988	5.9 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.586 億美元，占銷售收入總額的 62.7%，同比增長 8.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 5,040 萬美元，同比減少 16.4%，主要由於智能卡芯片及超級結產品的需求減少。
- 本季度通訊產品銷售收入 3,480 萬美元，同比增長 47.5%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 920 萬美元，同比持平。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	50	53
7 號晶圓廠 (300mm)	14	-	10
合計折合 8 吋產能	210	175	201
產能利用率 (200mm)	102.0%	96.5%	100.4%
產能利用率 (300mm)	56.4%	-	38.3%
總體產能利用率	95.8%	96.5%	93.4%

- 本季度末月產能達 210,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 95.8%，環比上升 2.4 個百分點。

付運晶圓

折合 8 吋仟片晶圓	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	577	524	523	10.1 %	10.3 %

- 本季度付運晶圓 577,000 片，同比增加 10.1%，環比增加 10.3%。

經營開支分析

以千美元計	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	1,612	1,925	1,925	(16.3)%	(16.3)%
管理費用 ⁷	72,588	38,259	60,587	89.7 %	19.8 %
經營開支	74,200	40,184	62,512	84.7 %	18.7 %

- 經營開支 7,420 萬美元，同比上升 84.7%，主要由於無錫工廠的研發開支及固定費用的上升，環比上升 18.7%，主要由於研發開支及人工費用的上升。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

⁷ 管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

其他收入淨額

以千美元計	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,257	3,142	3,071	3.7 %	6.1 %
利息收入	2,433	3,479	2,960	(30.1)%	(17.8)%
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	225	5,713	1,658	(96.1)%	(86.4)%
匯兌收益/(損失)	3,224	3,881	(361)	(16.9)%	(993.1)%
分佔一家聯營公司溢利	5,998	2,720	4,362	120.5 %	37.5 %
財務費用	(579)	(294)	(301)	96.9 %	92.4 %
政府補貼	9,217	4,685	453	96.7 %	1,934.7 %
其他	281	191	158	47.1 %	77.8 %
其他收入淨額	24,056	23,517	12,000	2.3 %	100.5 %

- 其他收入淨額 2,410 萬美元，同比上升 2.3%，主要由於政府補貼及分佔一家聯營公司溢利增加，部分被以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益及利息收入減少所抵消，環比上升 100.5%，主要由於政府補貼增加，及本期实现汇兑收益而上期为汇兑损失。

現金流量分析

以千美元計	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	89,410	70,682	101,847	26.5 %	(12.2)%
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(315,355)	(421,707)	81,493	(25.2)%	(487.0)%
融資活動所得/(用)現金流量淨額	222,096	(171)	(3,230)	(129,980.7)%	(6,976.0)%
外匯匯率變動影響淨額	21,351	(8,812)	545	(342.3)%	3,817.6 %
現金及現金等價物變動影響淨額	17,502	(360,008)	180,655	(104.9)%	(90.3)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 8,940 萬美元，上年同期為 7,070 萬美元，主要由於收到增值稅退稅款，部分被增加的人工費用支出所抵消。
- 投資活動所用現金流量淨額 3.154 億美元，其中固定資產及無形資產投資支出 4.036 億美元，部分被(i) 贖回以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資 8,690 萬美元，及(ii)利息收入 130 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 2.221 億美元，其中(i) 提取銀行借款 2.195 億美元，及(ii) 發行股份收到 370 萬美元，部分被(i) 租賃負債支出 100 萬美元，及(ii) 支付利息 10 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)
資產總額	4,022,672	3,575,890
負債總額	847,962	526,107
所有者權益總額	3,174,710	3,049,783
資產負債率 ⁸	21.1%	14.7%

資本開支

以千美元計	二零二零年 第三季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)
華虹 8 吋	52,407	33,272
華虹無錫	351,179	144,801
合計	403,586	178,073

- 本季度資本開支 4.036 億美元，其中 3.512 億美元用於華虹無錫。

⁸資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)
存貨	205,223	176,856
貿易應收款項及應收票據	122,938	135,518
預付款項、按金及其他應收款項	66,261	66,174
應收關聯方款項	11,292	11,588
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	-	84,759
已凍結存款及定期存款	345	766
現金及現金等價物	716,459	698,957
流動資產總額	1,122,518	1,174,618
貿易應付款項	96,232	92,607
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	386,672	318,489
計息銀行借款	223,844	4,238
租賃負債	3,513	3,757
政府補助	59,076	40,105
應付關聯方款項	12,790	13,467
應付所得稅	21,350	14,292
流動負債總額	803,477	486,955
淨營運資金	319,041	687,663
速動比率	1.1x	2.0x
流動比率	1.4x	2.4x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	47	59
存貨周轉天數	90	89

- 存貨由上季度末的 1.769 億美元上升至本季度末的 2.052 億美元，主要由於客戶需求增加。
- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 1.355 億美元下降至本季度末的 1.229 億美元，主要得益於客戶信用管理的提升。
- 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產由上季度末的 8,480 萬美元下降至本季度末的零，主要由於理財產品的贖回。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 3.185 億美元上升至本季度末的 3.867 億美元，主要由於應付資本性開支增加。
- 計息銀行借款由上季度末的 420 萬美元上升至本季度末的 2.238 億美元，主要由於本季度提取短期銀行借款。
- 政府補助由上季度末的 4,010 萬美元上升至本季度末的 5,910 萬美元，主要由於收到政府補助資金。
- 應付所得稅由上季度末的 1,430 萬美元上升至本季度末的 2,140 萬美元，主要由於計提本季度應付所得稅。
- 本季度末淨營運資金 3.190 億美元，流動比率 1.4。
- 本季度末貿易應收款項及應收票據周轉天數 47 天。
- 本季度末存貨周轉天數 90 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)
銷售收入	252,981	238,993	225,350
銷售成本	(191,689)	(164,981)	(166,840)
毛利	61,292	74,012	58,510
其他收入及收益	18,641	21,117	8,303
銷售及分銷費用	(1,612)	(1,925)	(1,925)
管理費用	(72,588)	(38,259)	(60,587)
其他費用	(4)	(26)	(364)
財務費用	(579)	(294)	(301)
分佔一家聯營公司溢利	5,998	2,720	4,362
稅前溢利	11,148	57,345	7,998
所得稅開支	(10,046)	(12,924)	(6,737)
期內溢利	1,102	44,421	1,261
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	17,694	45,225	17,826
非控股權益	(16,592)	(804)	(16,565)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.014	0.035	0.014
攤薄	0.013	0.035	0.014
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,294,890,812	1,285,596,506	1,291,439,564
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,317,522,812	1,293,558,506	1,300,881,564

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	2,272,520	1,790,860	1,563,446
使用權資產	77,323	75,810	73,447
投資物業	172,727	166,154	166,148
無形資產	33,603	32,201	11,715
於聯營公司的投資	88,494	79,335	65,805
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	212,754	204,658	202,179
長期預付款項	33,445	42,100	8,376
應收關聯方款項	180	1,994	6,714
遞延稅項資產	9,108	8,160	8,005
非流動資產總額	2,900,154	2,401,272	2,105,835
流動資產			
存貨	205,223	176,856	133,117
貿易應收款項及應收票據	122,938	135,518	140,398
預付款項、按金及其他應收款項	66,261	66,174	103,889
應收關聯方款項	11,292	11,588	6,152
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	-	84,759	611,632
已凍結存款及定期存款	345	766	765
現金及現金等價物	716,459	698,957	474,670
流動資產總額	1,122,518	1,174,618	1,470,623
流動負債			
貿易應付款項	96,232	92,607	81,675
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	386,672	318,489	301,966
計息銀行借款	223,844	4,238	4,242
租賃負債	3,513	3,757	1,357
政府補助	59,076	40,105	76,497
應付關聯方款項	12,790	13,467	10,509
應付所得稅	21,350	14,292	27,461
流動負債總額	803,477	486,955	503,707
流動資產淨額	319,041	687,663	966,916
總資產減流動負債	3,219,195	3,088,935	3,072,751
非流動負債			
計息銀行借款	19,823	19,069	23,328
租賃負債	17,311	16,889	16,258
遞延稅項負債	7,351	3,194	12,805
非流動負債總額	44,485	39,152	52,391
淨資產	3,174,710	3,049,783	3,020,360
權益和負債權益			
股本	1,974,417	1,971,748	1,963,245
儲備	394,214	286,489	219,213
本公司擁有人應佔權益	2,368,631	2,258,237	2,182,458
非控股權益	806,079	791,546	837,902
權益總額	3,174,710	3,049,783	3,020,360

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零二零年 (未經審核)	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	11,148	57,345	7,998
折舊及攤銷	56,791	25,814	47,579
應佔聯營公司溢利	(5,998)	(2,720)	(4,362)
營運資金的變動及其它	27,469	(9,757)	50,632
經營活動所得現金流量淨額	89,410	70,682	101,847
投資活動所(用)得現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(403,586)	(459,805)	(178,073)
其他投資活動所得現金流量	88,231	38,098	259,566
投資活動所(用)得現金流量淨額	(315,355)	(421,707)	81,493
融資活動所得/(用)現金流量：			
提取銀行貸款	219,439	-	-
發行股份所得收益	3,741	29	17
償還銀行貸款	-	-	(2,119)
償還租賃負債	(1,009)	(114)	(1,050)
已付利息	(75)	(86)	(78)
融資活動所得/(用)現金流量淨額	222,096	(171)	(3,230)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(3,849)	(351,196)	180,110
外匯匯率變動影響淨額	21,351	(8,812)	545
期初現金及現金等價物	698,957	834,678	518,302
期末現金及現金等價物	716,459	474,670	698,957

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

杜洋

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二零年十一月十日